**证券代码：688535 证券简称：华海诚科**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 √业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  √现场参观 □电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 山西证券、银河证券、中邮证券、线上业绩说明会 |
| **会议时间** | 2023年 11月 29日10：00-11：00 |
| **会议地点** | 现场；线上 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长、总经理：韩江龙  董事会秘书：董东峰  证券事务代表：钱云  证券事务专员：张雅婷 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 问题一：华为开始进军芯片封测，请问公司与华为是否有业务来往。另外，公司如何把握好这一轮行业回暖的机会，做强做大企业？  回复：由于涉及保密协议，不便透露具体情况；目前行业预测明年会有较大增长，作为企业，我们会持续加大研发投入，抓住国产化替代机遇，努力拓展市场，服务好客户。  问题二：公司曾表示在先进封装领域积极配合华为等业内新概念厂商开展研发工作，目前部分产品已陆续通过考核验证。请问，针对的是哪些产品？HBM和GPU、CPU吗？  回复：公司在先进封装领域持续加大研发投入（如GMC、LMC、FC底填胶、高导热、耐高电压材料等），具体情况请见公司招股书及半年度报告。公司会根据实际情况及时披露。  问题三：请对2023年第三季度业绩做一下简要说明  回复：2023年三季度收入同比下降2.65%，净利润下降6.66%。消费电子复苏虽不如预期，但是1-3季度数据环比有所增长。  问题四：据研究显示，AI服务器出货动能强劲带动HBM（高带宽存储器）需求提升，HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握。但是看华海诚科的招股说明书中公司也有GMC技术，能不能介绍下相关情况和应用前景？  回复：公司自研的GMC设备可以满足GMC的生产制造，目前有相关产品在送样测试过程中。相比于LMC（液态塑封料）GMC（颗粒状塑封料）有较大的成本优势，在先进封装领域有部分替代LMC的趋势，市场前景广阔。  问题五：贵司高端环氧塑封料已经突破外国垄断，已经实现出货量产。希望贵司多描述一些客户情况和销售增速。  回复：高端塑封料的技术突破到小批量出货到真正的批量需要相当长的时间，现阶段在高端塑封料领域外资仍处于主导地位，即便有部分高端塑封料实现了量产出货，但是进口替代仍然需要凭借不懈的技术开拓、稳定的产品质量、完善及时的客户服务逐步推进。  问题六：贵司基础类和先进封装类分别占比大概有多少？  回复：基础类占40%多一点，高性能大约55%，先进封装占剩余部分，基本为个位数，可以忽略不计。  问题七：消费电子随着华为的复苏呈现出向好趋势，请问公司有主要客户追加订单吗？  回复：公司一、二、三季度环比出货有所改善，具体情况请参考公司披露的半年度报告和三季度报告。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2023年11月 29日 |